



HY-P 系列 导热界面材料
Series Thermal Interface Material

专为电子零部件降温设计的导热界面材料
Special Design for Electronic Components Heat Transfer

项目 Items	HY-P7	HY-P11	HY-P13	单位Unit
颜色 Color	灰色 Grey	灰色 Grey	灰色 Grey	No
热传导系数 Thermal Conductivity	7.35 ~ 13.4			W/m-k
热阻抗 Thermal Impedance	0.0015	0.0012	0.001	°C-in ² /W
比重 Specific Gravity	2.07	3.47	2.5	g/cm ³
浓度 Thixotropic Index	370±10	340±10	350±10	1/10mm
瞬间耐温度 Moment Bore Temperature	-50-230	-50-230	-50-230	°C
工作温度 Operation Temperature	-30-180	-30-180	-30-180	°C

成份 Ingredients

矽化合物 Silicone Compounds	15	12	15	%
碳化合物 Carbon Compounds	30	28	25	%
氧化金属化合物 Metal Oxide Compounds	55	60	60	%
包装 Package	针管		吊卡	
	TU		Other	
	0.5g-30g		0.5g-5g	

产品图片 Products Pictures



执行标准: Q/HYTG 001-2017

※本产品耐温、阻燃,一般常温储存方式即可

Thermal Interface Materials Temperature Resistant, Flame Retardant and Storage at room temperature

以上数据由深圳市华能智研电子有限公司实验室测试所得,该实验室保留最终解释权

All data above are provided Shenzhen Halnziye Electronics Co., Ltd Halnziye All Rights Reserved

